

# BGA Heat Sink - High Performance Device Specific - NXP



|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ATS Part#:              | ATS-59000-C1-R0                                                                |
| Description:            | 21.00 x 45.00 x 9.00 mm BGA Heat Sink - High Performance Device Specific - NXP |
| Heat Sink Type:         | NXP                                                                            |
| Heat Sink Attachment:   | maxiGRIP                                                                       |
| Equivalent Part Number: | ATS-59000-C2-R0 Discontinued                                                   |

*\*Image above is for illustration purpose only.*

## Features & Benefits

- Designed for flip-chip processors such as NXP MPCs
- maxiGRIP™ attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- Comes preassembled with high performance, phase changing, thermal interface material

## Thermal Performance

| AIR VELOCITY       |               | @200 LFM<br>1.0 M/S | @300 LFM<br>1.5 M/S | @400 LFM<br>2.0 M/S | @500 LFM<br>2.5 M/S | @600 LFM<br>3.0 M/S | @700 LFM<br>3.5 M/S | @800 LFM<br>4.0 M/S |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| THERMAL RESISTANCE | Unducted Flow | 6.1 °C/W            | 5 °C/W              | 4.4 °C/W            | 3.9 °C/W            | 3.6 °C/W            | 3.4 °C/W            | 3.3 °C/W            |
|                    | Ducted Flow   | 4.2                 | N/A                 | N/A                 | N/A                 | N/A                 | N/A                 | N/A                 |

## Product Detail

| Schematic Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | TIM  | Finish         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|----------------|
| <p><i>*Image above is for illustration purpose only.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.00 mm    | 45.00 mm    | 9.00 mm     | 59 mm       | T766 | BLACK-ANODIZED |
| <b>Notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension <b>A</b> and <b>B</b> refer to component size.</li> <li>Dimension <b>C</b> is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field.</li> <li>ATS-59000-C2-R0 is the exact heat sink assembly with an equivalent thermal interface material (Saint Gobain C1100F). NOTE: Saint Gobain C1100F is discontinued effective 12/31/10.</li> <li>Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application.</li> <li>ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance.</li> <li>ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant.</li> <li>Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: <b>MGT170</b></li> <li>Contact ATS to learn about custom options available.</li> </ul> |             |             |             |             |      |                |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9